

证券代码：603920

证券简称：世运电路

公告编号：2023-021

转债代码：113619

转债简称：世运转债

## **广东世运电路科技股份有限公司**

### **关于预计 2023 年度公司与子公司向银行申请 综合授信额度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东世运电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度公司与子公司向银行申请综合授信额度的议案》。

公司目前正处于快速发展阶段，为满足公司日常生产经营需要，提高公司经营效益，结合公司财务状况及资金计划安排，公司及子公司鹤山市世安电子科技有限公司、奈电软性科技电子（珠海）有限公司、世运线路版有限公司、世运电路科技有限公司、深圳市世运线路版有限公司、鹤山市世拓电子科技有限公司、江门市世运微电科技有限公司、广东世电科技有限公司（以下合称“子公司”）在 2023 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 30 亿元的综合授信，业务范围包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银行保理、信用证等各种贷款及融资等有关业务。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信额度可在授信期限内循环使用。

授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款，同时授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件），期限为自股东大会审议通过之日起一年。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司及子公司实际发生的融资金额为准。

该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司全体独立董事已就上述事宜发表独立意见：

鉴于发展和生产经营需要，公司及子公司在 2023 年度拟向各合作银行申请总额最高不超过人民币 30 亿元的综合授信。经审核，我们认为公司提出的上述预计申请授信事宜，系基于公司及子公司生产经营和发展需要，为拓宽融资渠道提高公司资金周转而进行，申请授信的必要性充分、合理，用途合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们对该议案没有异议，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告

广东世运电路科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日